

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-108

## 昆山万源通电子科技股份有限公司

### 关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万源通”）于2026年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023年9月20日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年10月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所2024年11月13日出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2024]493号）批准，公司股票于2024年11月19日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票3,100.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.16元，募集资金总额为人民币345,960,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币41,531,033.96元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币304,428,966.04元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年11月12日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0045号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。公司已于 2024 年 12 月 19 日收到超额配售选择权新增发行 465.00 万股对应的募集资金总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0054 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司（以下简称“江苏广谦”）已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 8 月 21 日，公司募集资金存储情况如下：

| 开户名称 | 开户银行        | 银行账号              | 金额（元）         |
|------|-------------|-------------------|---------------|
| 江苏广谦 | 招商银行昆山高新区支行 | 512912454610008   | 42,336,468.11 |
| 江苏广谦 | 宁波银行昆山支行    | 86021110000796749 | 20,098,767.41 |
| 合计   |             |                   | 62,435,235.52 |

注：上表募集资金金额不包含已购买但尚未到期的现金理财产品 5,000.00 万元人民币。

（三）超募资金情况

2025 年 3 月 30 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金 5,951,537.36 元用于永久补充流动资金。公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会审议通过了上述议案。截至 2025 年 4 月 28 日，超募资金 5,951,537.36 元已全额使用完毕。

（四）募集资金置换情况

公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金

置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 27,667,904.50 元及发行费用的自筹资金 5,837,325.47 元。

公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。公司使用银行承兑汇票的方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为 149,850.32 元。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 3 月 6 日，公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议、第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 8 月 21 日，公司已使用闲置募集资金 2,999.50 万元用于暂时补充流动资金，未超过审议额度及有效期限。

三、募投项目具体情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                    | 实施主体 | 拟投入募集资金金额 |
|----|-----------------------------------------|------|-----------|
| 1  | 新能源汽车配套高端印制电路板项目<br>（年产 50 万平方米刚性线路板项目） | 江苏广谦 | 25,570.30 |
| 2  | 补充流动资金与偿还银行贷款                           | 公司   | 9,025.70  |
| 3  | 超募资金永久补充流动资金                            | 公司   | 595.15    |
| 合计 |                                         |      | 35,191.15 |

四、本次募投项目结项情况

（一）募投项目结项情况及资金节余情况

截至 2026 年 8 月 21 日，公司“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产

50 万平方米刚性线路板项目）”已完成建设并达到预定可使用状态，现予以结项。募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 募投项目名称                                          | 募集资金计划<br>投资总额（A） | 累计投入募<br>集资金金额<br>（B） | 待支付工程<br>设备期款（C） | 现金管理收益及<br>利息收入扣除手<br>续费后净额（D） | 项目节余资金金<br>额（A-B-C+D） |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 新能源汽车配套高端<br>印制电路板项目（年<br>产 50 万平方米刚性线<br>路板项目） | 25,570.30         | 11,666.86             | 5,191.40         | 339.58                         | 9,051.62              |

注：①上表金额未经审计。

②由于节余资金持续产生银行利息及结构性存款尚未到期，节余募集资金金额具体以划转资金日的银行结算资金余额为准。

③上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。下同。

（二）募集资金节余的原因

公司“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”计划总投资 25,570.30 万元，截至 2026 年 8 月 21 日累计投入募集资金 11,666.86 万元，待支付工程设备期款 5,191.40 万元，节余募集资金 9,051.62 万元（含现金管理收益及利息收入），主要系：（1）工程建设投资方面：受房地产行业整体的影响，公司在建设环节的议价能力显著提升，加之在实施过程中积极统筹现有资源，并采用更具成本效益的建设方案，有效压缩了建设投入。（2）设备软件投资方面：①随着主要设备和软件国产替代进程加速，国内供应商数量增多、市场竞争充分，公司采购议价空间扩大，大幅节约了设备购置成本；②募投项目原按大批量订单规划产能，而东台工厂实际接单仍以中小批量订单为主，部分自动化工序的设备投入性价比较低，因此公司选择以人工操作替代；③公司继续沿用了部分原有旧设备，进一步减少了新增设备采购支出。

五、节余募集资金后续使用计划

公司结合实际经营情况，为提升资金使用效率，本次募投项目结项后节余募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 节余募集资金的用途           | 项目总投资     | 拟投入募集资金  |
|---------------------|-----------|----------|
| 高密度互连印刷电路板（HDI）项目一期 | 50,000.00 | 9,051.62 |

注：由于节余资金持续产生银行利息及结构性存款尚未到期，节余募集资金金额具体以划转资金日的银行结算资金余额为准。

“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”结项后，江苏广谦在招商银行昆山高新区支行开户的募集资金专户（银行账号：512912454610008）一方面继续用于“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”工程设备期款的支付，另一方面也将用于“高密度互连印刷电路板（HDI）项目一期”的募集资金存储、使用与管理，届时公司将按照相关要求，及时与保荐机构、商业银行签署补充协议。

六、节余募集资金实施新项目的概况

（一）新项目概况

- 1、项目名称：高密度互连印刷电路板（HDI）项目一期
- 2、实施主体：江苏广谦
- 3、项目投资额：50,000.00 万元，其中拟投入募集资金 9,051.62 万元（具体金额以实际结转时项目专户余额为准，包含产生的理财收益和利息收入），超出部分由公司以自有资金或自筹资金等方式投入。
- 4、项目建设周期：18 个月
- 5、项目建设内容：本项目拟对东台生产基地进行扩建，通过购置土地、引进先进生产设备，搭建自动化、高端化、柔性化的 HDI 生产线，是公司推进战略转型升级的重要举措。项目的实施，一方面将把握 PCB 行业高端化转型机遇，进一步扩充 HDI 产品产能，深度布局智能驾驶、光通信、AI 服务器等高景气赛道，抢占高端市场份额；另一方面将突破高端产品工艺壁垒，优化产品与客户结构，提升高附加值产品营收占比，强化公司盈利能力；此外，通过夯实技术壁垒，构筑长期核心竞争优势，助力公司在新一轮产业升级浪潮中稳固行业地位，实现稳健可持续发展。

（二）新项目投资概算

本项目计划总投资 50,000.00 万元。具体构成如下：

| 序号    | 项目      | 投资估计（万元）  | 拟投入募集资金（万元） |
|-------|---------|-----------|-------------|
| 1     | 土地成本    | 906.00    | 0.00        |
| 2     | 建设投资    | 10,814.00 | 4,000.00    |
| 3     | 设备和软件投资 | 35,425.00 | 5,051.62    |
| 4     | 铺底流动资金  | 2,855.00  | 0.00        |
| 总投资金额 |         | 50,000.00 | 9,051.62    |

（三）新项目建设的必要性及可行性分析

1. 抢抓行业高端化转型机遇，扩大 HDI 产能，布局高景气核心增长赛道

当前，AI 算力产业快速扩张、算力基础设施持续落地，叠加新能源汽车、工业智能化全面升级，PCB 行业迎来结构性增长新阶段。传统消费电子领域需求逐步回暖，AI 服务器、高速光通信、智能驾驶等高景气赛道需求持续扩容，促使 PCB 产品向高频高速、低信号损耗、高精密度、高集成化、高散热性等高附加值方向迭代，高多层板、高阶 HDI 等产品市场供给短缺，行业高端化趋势凸显，HDI 已成为支撑 PCB 行业中长期增长的核心品类。

2. 优化产品结构，强化整体盈利能力，推动公司战略转型升级

目前，公司产品结构以常规多层板、单双面板为主，正积极拓展面向智能驾驶、光模块、AI 服务器领域的中高端 HDI 产品，亟需通过产品层级的跃升，提高公司盈利水平，优化整体产品结构，推动公司转型升级。本项目的实施是公司实现战略转型升级的重要举措。项目建成后将有效扩大公司 HDI 产品产能，显著提升高附加值产品的营收占比。这不仅有助于优化公司的产品与客户结构、提升整体盈利能力，更是公司培育新利润增长点、在新一轮产业升级浪潮中稳固竞争优势的关键战略部署。

3. 优质的客户资源，是本项目产能消化的保证

凭借强大的技术创新能力、快速响应客户的能力和严格的质量管控体系，公司建立了稳定高效的生产运营体系，行业知名度与品牌影响力持续提升，积累了丰富优质的客户资源。公司业务布局覆盖全国、辐射全球，产品远销北美、欧洲、韩国、东南亚等地区，广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制、智能家居、通信设备等领域。凭借对下游应用场景的深入洞察，公司销售团队贯穿产品全生命周期与客户高效协同，满足客户定制化、快速交付的需求，与国内外知名客户

建立了良好的合作关系。

此外，公司二阶 HDI 产品已实现量产交付，三阶 HDI 产品已经送样通过待量产；并正与客户合作开发四阶 HDI 和任意互联 HDI 产品，目前正处于打样验证阶段。相关产品的突破与客户认证，充分印证了公司在高端 PCB 领域的技术实力与市场认可度。

#### 4. 扎实的技术研发实力，是本项目实施的坚实基础

公司作为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业，深耕 PCB 领域多年，已构建成熟完善的技术研发体系，积累了丰富的技术经验与创新成果，技术创新能力持续增强，为本次项目提供坚实技术支撑。

公司在追求全面技术矩阵的同时，紧跟下游电子产品的发展趋势，精准对接 AI 服务器、智能驾驶等市场爆发点，通过将产能与研发资源向高密度互连 HDI 板、高频高速板等高附加值产品倾斜，通过深入研究材料特性，在钻孔、电镀、蚀刻、防焊和化锡等环节改善生产工艺和核心技术，满足客户各项品质要求。与此同时，公司持续围绕市场需求、前瞻技术等进行了 800G 高速光模块 PCB 技术、任意层 HDI 板压合涨缩稳定性、镭射最小孔径加工能力、脉冲电镀极限孔径(20:1)深镀能力等的项目研发工作，进一步对项目技术工艺形成技术支撑。

#### （四）新项目建设的风险分析和应对措施

##### 1. 需求波动风险及控制措施

PCB 产品应用领域广泛，其需求与下游行业发展及全球宏观经济形势密切相关。当前，受地缘政治、贸易摩擦等因素影响，国内外宏观经济存在一定不确定性。若未来宏观经济明显回落或下游行业出现周期性深度回调，PCB 行业需求增速可能放缓甚至下滑，进而对公司经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将持续加大研发力度，提升产品良率与精密制程能力，强化核心竞争力；同时，坚持以市场需求为导向，紧跟市场发展动态，深耕 AI 服务器、高速光通信、汽车智能驾驶等高景气赛道，优化产品结构，培育新的业务增长点，以平抑单一下游市场周期波动带来的影响。

##### 2. 市场竞争风险及控制措施

PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场集中度相对较低。随着国内头部 PCB 企业纷纷扩产，大型企业的竞争优势愈发凸显，行业集中度逐步提升，

市场竞争日益激烈。若未来下游领域需求增速不及预期，或行业扩产产能集中释放，而公司未能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量，则可能在市场竞争中处于不利地位，导致经营业绩下滑。

针对上述风险，公司将进一步提高自身产品质量及客户服务能力，增强客户粘性与市场口碑，强化品牌效应；同时进一步加大研发投入，紧跟技术革新与客户需求变化，以技术领先和品质卓越构筑竞争壁垒，巩固核心竞争优势。

## **七、本次结项募投项目的节余募集资金用于实施新项目对公司的影响**

“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”已达到预定可使用状态，予以结项，节余募集资金用于高密度互连印刷电路板（HDI）项目一期系公司根据发展战略规划做出的审慎决定，有利于公司升级转型，实现主营业务结构和盈利能力的重大突破，增强核心竞争力，为股东创造更大的利益。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定。

## **八、审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

2026 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

### **（二）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”结项并将节余募集资金实施新项目已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金实施新

项目的事项无异议。

## 九、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（三）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的核查意见》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日